

昌平手机IC诚心收购 回收芯片公司服务咨询

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 昌平手机IC诚心收购 回收芯片公司服务咨询 |
| 公司名称 | 深圳市科启达电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:进口 型号:不限 产地:不限 |
| 公司地址 | 深圳市福田区中航路国利大厦1607 |
| 联系电话 | 0755-83298239 13824335470 |

产品详情

昌平手机IC诚心收购 回收芯片公司服务咨询

SC8560

RC3216F433CS

BAT54BRW-7-F

贴片存储IC_NT5CC64M16GP-DII

GD25LQ40BTIGR

PRS6045-220MT

RC0805JR-073KL

GCM21BR72A223KA37

RTT03102JTP

3296X-1-104

CC0603JRNPO9BN751

RF1658TR13

半导体芯片的制造过程可以分为沙子原料（石英）、硅锭、晶圆、光刻，蚀刻、离子注入、金属沉积、金属层、互连、晶圆测试与切割、核心封装、等级测试、包装等诸多步骤，而且每一步里边又包含更多细致的过程。

- 1、沙子：硅是地壳内第二丰富的元素，而脱氧后的沙子（尤其是石英）最多包含25%的硅元素，以二氧化硅（ SiO_2 ）的形式存在，这也是半导体制造产业的基础。
- 2、硅熔炼：12英寸/300毫米晶圆级，下同。通过多步净化得到可用于半导体制造质量的硅，学名电子级硅（EGS），平均每一百万个硅原子中最多只有一个杂质原子。此图展示了是如何通过硅净化熔炼得到大晶体的，最后得到的就是硅锭。
- 3、单晶硅锭：整体基本呈圆柱形，重约100千克，硅纯度99.9999%。
- 4、硅锭切割：横向切割成圆形的单个硅片，也就是我们常说的晶圆（Wafer）。
- 5、晶圆：切割出的晶圆经过抛光后变得几乎完美无瑕，表面甚至可以当镜子。
- 6、光刻胶（Photo Resist）：图中蓝色部分就是在晶圆旋转过程中浇上去的光刻胶液体，类似制作传统胶片的那种。晶圆旋转可以让光刻胶铺的非常薄、非常平。